

Nowość!

KOKI Company Limited

32-1 Senju-Asahi Cho, Adachi-Ku, Tokyo Japan #120-0026

TEL: +81 3-5244-1511 FAX: +81 3-5244-1527

www.ko-ki.co.jp



Marzec 2021

Nowa pasta lutownicza o niskiej temperaturze topnienia do komponentów i PCB wrażliwych na wysokie temp.

Nowa technologia zapobiega wysychaniu pasty lutowniczej, umożliwiając jej stabilne działanie.

Chcielibyśmy poinformować, że firma KOKI właśnie wprowadziła na rynek nowe pasty do lutowania rozplwowego o niskiej temperaturze topnienia.

Z punktu widzenia istniejącego trendu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i niezawodności modułów elektronicznych, od pewnego czasu obserwujemy większe zapotrzebowanie na pastę lutowniczą o niskiej temperaturze topnienia. Aby sprostać tym założeniom, na rynku dostępnych jest kilka produktów na bazie stopu Cyna – Bizmut.

Konwencjonalne pasty lutownicze Sn-Bi często zawierają duże ilości stosunkowo silnego aktywatora zapewniającego zwilżalność i koagulację równoważną do SAC305. Jeśli zastosowana temperatura nie jest wystarczająca to pozostały po lutowaniu aktywator może stanowić zagrożenie dla niezawodności modułu, nawet jeśli pasta lutownicza jest zaprojektowana tak, aby rozpuszczalnik łatwo odparował, zapewniając lepszą odporność na izolację powierzchniową. Jest to tylko kompromis, ponieważ pasta lutownicza może przez to zbyt szybko wysychać, negatywnie wpływając na drukowanie pasty, lepkość i kleistość.

Nowo wprowadzone pasty lutownicze **T4AB58-HF360** do sitodruku i **T4AB58-HF360D** do dozowania zawierają zoptymalizowaną ilość starannie dobranej aktywatora, który skutecznie ułatwia odparowanie, minimalizując w ten sposób ilość potrzebnego aktywatora topnika, jednocześnie zapewniając doskonałą zwilżalność i koagulację. Poprawia to nie tylko rezystancję, ale także pomaga osiągnąć stabilność podczas całego procesu. Zabezpiecza również komponenty aby zostały na swoim miejscu w trakcie i po procesie układania.

- **Pasta lutownicza o niskiej temperaturze topnienia na bazie Sn-Bi przeznaczona do pieców rozplwowych bez konieczności używania azotu**

Skład stopu **T4AB58-HF360** i **T4AB58-HF360D** to Sn, 0,4Ag i 57,6Bi o temperaturze topnienia od 138 do 140 stopni Celsjusza jest odpowiedni do lutowania wrażliwych na temperaturę elementów i PCB w atmosferze powietrza.

- **Nowoczesna technologia zapobiega wysychaniu pasty i zapewnia stabilną aplikację**

Nowa technologia zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu pasty lutowniczej, aby przy ciągłej pracy zapewnić stabilny proces nakładania. Pomaga również w utrzymaniu w odpowiedniej pozycji komponentów podczas i po zakończeniu procesu układania.

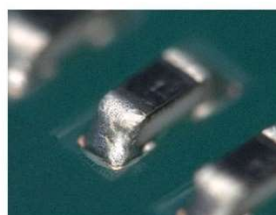
- **Osiągnięto doskonałą zwilżalność i ograniczono pustki**

T4AB58-HF360 i **T4AB58-HF360D** wykazują doskonałą topliwość, zwilżalność i koagulację dzięki aktywatorowi, który skutecznie współpracuje ze stopem na bazie Sn-Bi. Powstałe spoiny mają niewielkie pustki (VOID).

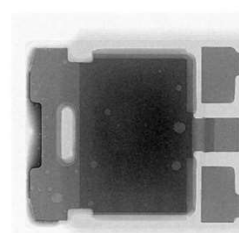
[Opis produktu]

Nazwa	T4AB58-HF360, T4AB58-HF360D
Skład stopu	Sn 0.4Ag 57.6Bi
Temp. topnienia	138 - 140
Rodzaj topnika	ROL0*
Wielkość ziarna (μm)	20 - 38

*Zgodnie z IPC J-STD-004B



0603R



Power Transistor
X-ray Image

KOKI COMPANY LIMITED

32-1. Senju Asahi-cho, Adachi-ku, Tokyo 120-0026, Japan Tel : +81 3 5244-1521 Fax : +81 3 5244-1525 www.ko-ki.co.jp